

GL7008

8K高速线阵CMOS图像传感器

GL7008是一款8K高速线阵CMOS图像传感器。芯片采用7 μm 像素设计，通过25对Sub-LVDS进行数据传输，其最高行频可达200 kHz。芯片支持黑白和彩色两个版本，黑白芯片支持单/双/三/四线模式，在实现高行频的同时，满足更高灵敏度的需求。彩色芯片支持RGB三线真彩色和RGBW四线多光谱输出，每条线可根据外部触发信号，单独调整曝光时间，使其更好进行色彩还原，同时该芯片的线间距为单个像素尺寸，以满足行频匹配的要求。**GL7008**在全速输出下功耗约为4.4 W，为了更好的解决芯片在高行频工作下的散热问题，该芯片采用了热导率更好的Invar金属+COB的封装，通过连接器将片上信号引出，直接连接相机板连接器，无需焊接和插座，使组装过程更简洁。



产品特性

- ▶ 全局快门
- ▶ 高行频
- ▶ 光学暗像素
- ▶ 片上温度传感器、SPI控制、PLL、时序

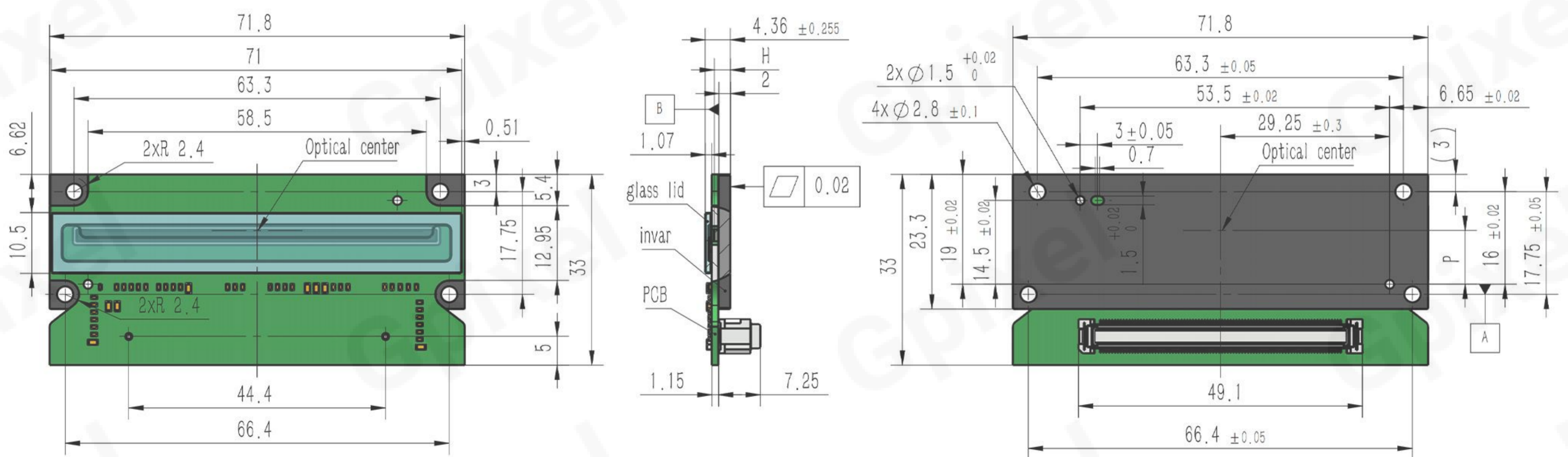
应用领域

- ▶ PCB检测
- ▶ 印刷检测
- ▶ 读码应用
- ▶ 3C检测
- ▶ 平板类检测
- ▶ 锂电检测

产品指标

有效分辨率	8192 (H) x 4 (V) 黑白 8192 (H) x 4 (V) 彩色	感光面长度	57.344 mm
像素尺寸	7 μm x 7 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	73.2% (530 nm)	读出噪声	6.8 e ⁻
满阱容量	10 ke ⁻	角度响应	20° (85% Response)
动态范围	63.3 dB	最高行频	200 kHz (单线) 100 kHz (双线)
输出接口	25对Sub-LVDS	通道合并	25/13/7/4
ADC	12 bit	最大数据率	24 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	4.4 W
供电电压	3.3 V(模拟), 1.8 V-3.3 V(IO) 1.8 V(数字)	封装形式	168 pins COB (71.8 mm x 33.0 mm)

封装信息



联系方式

长春 (总部)

长春长光辰芯微电子股份有限公司
吉林省长春市经开区自由大路7691号
光电信息产业园一期1号、5号办公楼
电话: 0431-85077785

杭州

杭州长光辰芯微电子股份有限公司
浙江省杭州市滨江区建业路599号
华业发展中心31楼3101-3109室
电话: 0571-87718606

大连

大连长光辰芯微电子股份有限公司
辽宁省大连市高新技术产业区
汇贤园7号11楼05D室
电话: 0411-39937666

